

## 第51回エンジニアリングセラミックスセミナー

「エンジニアリングセラミックスに関わるプロセス技術の革新」

### 概要

環境・エネルギー分野で活躍している先進セラミックスは、原料粒子の設計、粉体技術、成形および焼成・固化技術等の要素技術の組み合わせで製造されている。セラミックスが本来持つ優れた特性は、これらの要素技術の原理を理解し、的確な微構造制御を施すことで発揮することができる。本セミナーでは、セラミックスプロセッシングおよび複合材料の分野でご活躍をされている先生方をお招きし、最先端のプロセス技術についてご講演をいただく。

主催：日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会

協賛：日本化学会，日本金属学会，耐火物技術協会，粉体粉末冶金協会，粉体工学会，日本ファインセラミックス協会（予定）

開催日時：2019年12月4日（水）

場所：東京工業大学田町キャンパス キャンパス・イノベーションセンター 国際会議室  
東京都港区芝浦3-3-6（URL: <http://www.cictokyo.jp/index.html>）  
JR田町駅芝浦口から徒歩1分，都営地下鉄浅草線・三田線三田駅から徒歩5分

定員：100名

参加費：会員13,000円（協賛学協会含む），学生会員6,000円，非会員15,000円  
（申込時入会は会員扱）（消費税・テキスト代込）

申込方法：HP（[http://www.ceramic.or.jp/bkouon/index\\_j.html](http://www.ceramic.or.jp/bkouon/index_j.html)）の申込フォームよりお申し込みください。参加費はセミナー前日までに銀行振込にてご送金ください。お申込後の取り消しによる返金はいたしません。

問合せ先：〒169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17

公益社団法人日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会

TEL：03-3362-5231，FAX：03-3362-5714，Email：encera@cersj.org

振込先：三菱東京UFJ銀行千里中央支店（普）0073211

（公社）日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会 名義  
銀行振込の振込受領書を領収書にかえさせていただきます

### 【プログラム】

13:30～13:35 開会挨拶

エンジニアリングセラミックス部会 部会長 東京大学 幾原雄一

13:35～14:15 「高純度アルミナの特徴と用途展開」

住友化学（株） 尾崎裕謙

14:15～14:55 「ジルコニア粉末とその用途」

東ソー（株） 植田邦義

休憩

15:10～15:50 「粒子集積化技術の確立と次世代ものづくりへの展開」

豊橋技術科学大学 武藤浩行

15:50～16:30 「セラミックスのコロイドプロセス—その多様性と可能性」

物質・材料研究機構 打越哲郎

休憩

16:45～17:25 「無焼成セラミックスの基礎と最近の展開」

名古屋工業大学 藤正督

17:25～18:05 「炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の界面制御技術と最近の展開」

岐阜大学 武野明義

18:05 閉会挨拶

エンジニアリングセラミックス部会 副部会長 TOTO（株） 清原正勝